

DE 29 20 012

1 / 1 WPAT - ©Thomson Derwent

Accession Nbr :

1980-L3896C [48]

Title :

Identification card incorporating integrated circuit chip - is mounted on support element resiliently mounted in oversized window in card

Derwent Classes :

P76 T04 T05

Patent Assignee :

(GESA) GAO GES AUTOMATION & ORG MBH

Inventor(s) :

HOPPE J; YAHYA HT


Nbr of Patents :


4


Nbr of Countries :


12

Patent Number :

 **DE2920012 B** 19801120 DW1980-48 *

 **EP--19280 A** 19801126 DW1980-49 Ger
DSR: AT BE CH FR GB IT LI LU NL SE

 **US4417413 A** 19831129 DW1983-50

 **EP--19280 B** 19840919 DW1984-38 Eng
DSR: AT BE CH FR GB IT LI LU NL SE

Priority Details :

1979DE-2920012 19790517

Citations :

DE2659573; US2637994; US3702464

IPC s :

B42D-015/02 G06K-007/06 G06K-019/06 G07C-001/14 G07C-009/00 G11B-005/80

Abstract :

DE2920012 B

The card (12) includes an integrated circuit chips for processing signals, which is mounted on a separate support element (18) subsequently inserted in a window in the surface of the card (12). The support element (18) has the same thickness as the card (12) with the window in the card (12) being oversized, the gap (22) between the edge of the support element (18) and the surrounding edge of the window bridges by resilient components.

Pref. the surface of the card (12) is protected on either side by an adhered foil (14, 16), with openings aligned with the contact zones (20) for the integrated circuit chip, the support element (18) held in position solely via these foils (14, 16).

Manual Codes :

EPI: T04-A03X T05-D T05-G03

Update Basic :

1980-48

Update Equivalents :

1980-49; 1983-50; 1984-38

⑤1

Int. Cl. 3:

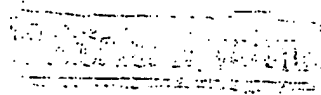
G 11 B 5/80

①9 **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

G 07 C 1/14

G 07 C 9/00

DEUTSCHES PATENTAMT



DE 29 20 012 B 1

①1

Auslegeschrift 29 20 012

②1

Aktenzeichen: P 29 20 012.2-53

②2

Anmeldetag: 17. 5. 79

④3

Offenlegungstag: —

④4

Bekanntmachungstag: 20. 11. 80

③1

Unionspriorität:

③2 ③3 ③1 —

⑤4

Bezeichnung:

Ausweiskarte mit IC-Baustein und Verfahren zur Herstellung einer derartigen Ausweiskarte

⑦1

Anmelder:

GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH, 8000 München

⑦2

Erfinder:

Yahya, Haghiri-Tehrani, Dipl.-Ing.; Hoppe, Joachim; 8000 München

⑤6

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:
Nichts ermittelt

Patentansprüche:

1. Ausweiskarte mit IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, der auf einem separaten Trägerelement befestigt ist und das Element in ein Fenster der Ausweiskarte eingesetzt ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (18) etwa die Dicke der Ausweiskarte aufweist und der IC-Baustein (30) im Inneren des Trägerelements (18) angeordnet ist und daß das dem Umriß des Trägerelements (18) ähnliche Fenster der Ausweiskarte größer ist als das Trägerelement, so daß das Trägerelement (18) von einem freien Spalt (22) umgeben ist und daß das Trägerelement (18) durch weitgehend elastische Verbindungselemente in dem Fenster gehalten ist.

2. Ausweiskarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorder- und Rückseite der Ausweiskarte mit einer Folie (14, 16) abgedeckt ist, die nur im Bereich der Kontaktflächen (20) des Trägerelements (18) eine Aussparung (24) aufweist.

3. Ausweiskarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckfolien (14, 16) aufgeklebt sind und das Trägerelement (18) allein von den Deckfolien (14, 16) in seiner Lage gehalten ist.

4. Ausweiskarte nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckfolien (14, 16) mit einem Druckbild versehen sind.

5. Ausweiskarte nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (18) einen kastenförmigen Aufbau aufweist, in dem sich der IC-Baustein (30) befindet.

6. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse des IC-Bausteins (30) im Durchkontaktier-Verfahren mit den Kontaktflächen (20) des Trägerelements verbunden sind.

7. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der IC-Baustein (30) im Inneren des Trägerelements (18) elastisch befestigt ist.

8. Ausweiskarte nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement eine größere Biegefestigkeit besitzt als das ihn umgebende Material der Ausweiskarte.

9. Ausweiskarte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (18) rund ist.

10. Ausweiskarte nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß Trägerelement (18) und Fenster der Ausweiskarte (10) Positionierhilfen aufweisen.

11. Verfahren zur Herstellung einer Ausweiskarte nach einem der Ansprüche 2 bis 10, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

- a) Ausstanzen des Fensters aus dem fertigen Ausweiskarteninlett,
- b) vorderseitige Deckfolie aufkaschieren und Fenster für Kontaktflächen ausstanzen,
- c) Einsetzen des Trägerelements in das Fenster,
- d) Kaltkaschieren des Ausweiskarteninletts mit rückseitiger Deckfolie,
- e) Ausstanzen der Ausweiskarte.

Die Erfindung betrifft eine Ausweiskarte mit IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, der auf einem separaten Trägerelement befestigt ist und das

Element in ein Fenster der Ausweiskarte eingesetzt ist.

Es ist bereits eine Ausweiskarte mit eingebettetem IC-Baustein bekannt. Der Baustein ist mit allen Zuleitungen und Kontakten auf einer Trägerplatte befestigt, die wiederum in eine Aussparung der ein Fenster der Ausweiskarte eingesetzt ist. Die Trägerplatte ist mit der Ausweiskarte durch Verkleben bzw. Verschweißen starr verbunden. Die Kontaktflächen befinden sich auf der gleichen Seite der Trägerplatte wie der aufgeklebte IC-Baustein. Der Zugang zu den Kontakten ist daher nur über entsprechende Löcher in der Ausweiskarte möglich.

Die bekannte Karte zeigt erstmals einen Weg auf, wie die empfindlichen IC-Bausteine in Ausweiskarten eingebettet werden können. Der bekannte Kartenaufbau weist jedoch noch so viele Nachteile auf, daß an eine praktische Verwendung dieser mit IC-Bauteilen ausgerüsteten Ausweiskarten vorerst nicht zu denken ist. Eine besondere Schwierigkeit ist die Verbindung des IC-Bauteils bzw. der Trägerplatte, auf der der IC-Bauteil aufgeklebt ist mit dem Kartenmaterial. Derartige Ausweiskarten werden bekanntlich durch den täglichen Gebrauch starken Biegebelastungen ausgesetzt, die sich bei dem bekannten Aufbau direkt auf die Zuleitungen des IC-Bausteins übertragen. Durch diese Wechselbeanspruchung kann es zu Zuleitungsunterbrechungen und Defekten des IC-Bausteins kommen.

Infolge der unterschiedlichen Biegefestigkeit der Trägerplatte einerseits und der Ausweiskarte andererseits kommt es an den Verbindungsnahten zu hohen Spannungskonzentrationen, die leicht zu einem Aufreißen und damit Lösen der Trägerplatte von der Ausweiskarte führen.

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Schwierigkeiten weist der bekannte Kartenaufbau noch weitere, durch seine spezifische Bauart bedingte Nachteile auf. Da die Kontaktflächen nur durch Löcher in der Ausweiskarte selbst zugänglich sind, besteht die Notwendigkeit, die Löcher mit leitendem Material zu füllen, um eine Verschmutzung der Kontakte zu verhindern. Dies erfordert einen zusätzlichen Arbeitsgang. Die Trägerplatte mit dem IC-Baustein hat eine solche Höhe, jedenfalls im eingebauten Zustand, daß sie nur in dem Bereich einer genormten Karte angeordnet werden kann, in dem Prägeausbuchtungen erlaubt sind. Diese Prägebereiche sind nach geltender Norm nur auf eine Zeilenbreite beschränkt, der IC-Baustein benötigt aber eine Ausbuchtung, die sich über mehrere Zeilen erstreckt. Es ist daher nicht möglich, die bekannten Karten so auszubilden, daß sie der geltenden Norm entsprechen.

Die für die Einlagerung der Trägerplatten erforderlichen mehrstufigen Ausbuchtungen mit unterschiedlichen Materialstärken sind bezüglich ihrer Herstellung relativ aufwendig, sie lassen sich darüber hinaus nur bei Vollplastik-Ausweiskarten anbringen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ausweiskarte der eingangs bezeichneten Art und ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Ausweiskarte zu schaffen, bei der die Verbindung zwischen dem Trägerelement mit dem IC-Baustein und dem Kartenkörper so gestaltet ist, daß sie auch sehr starken Biegewechselbelastungen standhält.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die im Kennzeichen des Hauptanspruchs angegebenen Merkmale gelöst.

Bei der Erfindung wird von der Erkenntnis Gebrauch gemacht, daß nicht der IC-Baustein selbst, sondern

bereits ein Zwischenerzeugnis in die Karte eingelagert werden muß, das den IC-Baustein und sämtliche zugehörigen Kontaktelemente aufweist. Die Fertigung dieses Trägerelements kann bei der dafür spezialisierten Elektronikfirma unter Verwendung hochwertiger Materialien und entsprechender Ansprüche an die Fertigung erfolgen. Das Einbringen der Trägerelemente in die Ausweiskarten dagegen kann unter Verwendung des üblichen Fachwissens bei dem auf Ausweiskartenherstellung spezialisierten Erzeuger erfolgen. Voraussetzung für den Erfolg der Erfindung ist die Ausgestaltung des Trägerelements als geschlossene Einheit, in dessen Inneren der IC-Baustein gelagert ist und auf dessen einer Seite sich die Kontaktflächen befinden. Beim Einsetzen der Trägerelemente in ein entsprechend geformtes Fenster der Ausweiskarte bleibt rings um das Trägerelement ein Zwischenraum, so daß auch bei extremer Biegung der Ausweiskarte kein direkter körperlicher Kontakt zwischen Ausweiskarte und Trägerelement, etwa durch ein Verkeilen, erfolgen kann. Das Trägerelement wird in seiner Lage durch elastische Verbindungselemente, die den Spalt zwischen Trägerelement und Ausweiskarte überbrücken, festgehalten.

Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung werden die elastischen Verbindungselemente durch auf Ober- und Unterseite des Karteninletts aufkaschierte Deckfolien gebildet. Das Trägerelement wird dabei lediglich von den Deckfolien, die beispielsweise selbstklebend sein können, im Fenster gehalten. Eine der Deckfolien muß selbstverständlich im Bereich der Kontaktflächen des Trägerelements eine entsprechende Aussparung aufweisen. Die Kontakte sind also, ohne einen zusätzlichen Arbeitsgang vorsehen zu müssen, frei zugänglich und somit selbstreinigend. Da die Deckfolien im sogenannten Kaltkaschierverfahren aufgebracht werden, wird der IC-Baustein auch thermisch nicht belastet.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

Durch die schwimmende Lagerung des als geschlossene Einheit ausgebildeten Trägerelements in einem Fenster der Ausweiskarte erhält die Karte auch unter extremen Wechselbelastungen eine solche Haltbarkeit, daß damit erstmals ihr praktischer Einsatz ermöglicht wird.

Das Verfahren zur Herstellung einer Ausweiskarte mit IC-Baustein wird durch die im Kennzeichen des Patentanspruches 11 angegebenen Maßnahmen ermöglicht.

Nachfolgend ist eine Ausführungsform der Erfindung anhand der Zeichnung beispielsweise beschrieben. Darin zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Ausweiskarte mit eingesetztem Trägerelement,

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Ausweiskarte und das Trägerelement und

Fig. 3 einen Querschnitt durch das Trägerelement allein.

Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Fenster, in das das Trägerelement eingesetzt ist, in einer Ecke der Ausweiskarte außerhalb der Hauptspannungsachsen angeordnet. Eine solche Anordnung hat sich als vorteilhaft erwiesen, weil sich die Karte in diesem Bereich nicht so stark verformt. Die Ausweiskarte 10 besteht wie üblich aus einem Karteninlett 12, das auf Ober- und Unterseite mit je einer Deckfolie 14, 16 kaschiert ist. Das Aufbringen der Folie kann im sogenannten Kaltkaschierverfahren erfolgen, d. h. ohne

Anwendung von Wärme. Das Karteninlett 12 kann V lplastik sein, möglich ist jedoch auch ein Mehrschichtentkörper aus Papier, der sämtliche, bei Ausweiskarten übliche Echtheitsmerkmale zusätzlich aufweisen kann.

In das kreisrunde Fenster in der oberen linken Ecke der Ausweiskarte (Fig. 1) ist ein Trägerelement 18 eingesetzt, das bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel scheibenförmig ist. Es kann einen Durchmesser von 15–20 mm aufweisen. Der Durchmesser des scheibenförmigen Trägerelements ist im wesentlichen durch die Anzahl der Kontakte bestimmt. Mit der Reduzierung der Zahl der Kontakte kann somit auch der Durchmesser verkleinert werden.

Das Element ist in eine entsprechende, in der Ausweiskarte 10 vorgesehene Aussparung eingesetzt, deren Durchmesser etwas größer als der Außendurchmesser des Trägerelements ist. Rings um das Trägerelement bleibt somit ein Ringspalt 22 stehen, dessen Größe so bemessen sein muß, daß auch bei einem maximalen Verbiegen der Ausweiskarte keine direkte Berührung der Seitenwände des Karteninletts 12 mit dem Trägerelement 18 erfolgt.

Das Trägerelement 18 wird in der Aussparung lediglich durch die beiden elastischen Deckfolien 14, 16 gehalten, die selbstklebend sind, so daß das Element 18 unverrückbar in der Aussparung positioniert bleibt.

Die Deckfolie 16 weist im Bereich der Anschlußflächen 20 des Trägerelements 18 eine Aussparung 24 auf, die einen Zugang zu den Kontakten 20 ermöglicht. Vorzugsweise sind beide Deckfolien 14, 16 bedruckt. Besonders im Bereich der Aussparung 24 kann ein deckendes Druckbild 9 vorgesehen sein, um damit die Verbindungsstelle zwischen Ausweiskarte und Trägerelement optisch abzudecken. Die Folie kann außerdem weitere Sicherheits- oder Funktionsmerkmale aufweisen, wie beispielsweise eine zusätzliche Magnetspur.

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf Fig. 3 das Trägerelement näher beschrieben, es besteht aus einer unteren Deckfolie 26, die mit einem Klebstoff beschichtet ist und auf die eine Dicken-Ausgleichsfolie 28 aufgelegt ist. Die Dicken-Ausgleichsfolie weist Ausstanzungen 34 auf, die groß genug sind, um einen IC-Baustein 30 frei aufnehmen zu können. Auf der Oberseite ist das Trägerelement 18 von einer Leiterfolie 32 abgedeckt, auf deren Vorderseite sich die Kontaktflächen 20 und auf deren Rückseite sich die Leiterbahnen 31 für den IC-Baustein 30 befinden. Die Leiterbahnen 31 sind mit den Kontaktflächen 20 auf der Vorderseite durchkontaktiert.

Die Kontaktflächen 20 haben vorzugsweise die gleiche Dicke wie die Dicke der Deckfolie 16, so daß die Oberfläche der Kontakte direkt mit der Oberfläche der Karte fluchtet und die Kontakte durch Reibung sich ständig selbst reinigen. Die Höhe bzw. Dicke des gesamten Trägerelements entspricht in diesem Fall der Dicke der Ausweiskarte abzüglich der Dicke der unteren Deckfolie 14.

Der IC-Baustein 30 wird im Inneren des Trägerelements 18 von einer elastischen Klebstoffmasse 33, beispielsweise einem Tropfen Silikonkleber, fixiert.

Die Deckfolie 26 und die Dicken-Ausgleichsfolie 28 sind relativ steif, so daß das Trägerelement 18 insgesamt sehr starr ist und nicht verbogen werden kann. Die Kastenbauweise des Elements stabilisiert dieses noch zusätzlich. Der im Inneren des Trägerelements auf dem elastischen Silikontr pfen befestigte IC-Baustein 30 ist somit optimal geschützt.

Zur Herstellung des Trägerelements 18 wird zunächst

die Leiterf lie 32 beidseitig mit Kupfer beschichtet. Daraufhin werden auf der Vorderseite der Leiterfolie die Kontaktflächen 20 und auf der Rückseite die Leiterbahnen 31 für den IC-Baustein ausgeätzt. Kontaktflächen und Leiterbahnen werden schließlich im Durchkontaktier-Verfahren miteinander verbunden.

Auf die Leiterfolie 32 wird anschließend eine Dicken-Ausgleichsfolie 28, die auch als Selbstklebefolie ausgebildet sein kann, in richtig positionierter Lage auflaminiert. Zuvor müssen in der Dicken-Ausgleichsfolie entsprechende Aussparungen 34 für die IC-Bausteine ausgestanzt werden. Die Aussparungen müssen größer sein als die IC-Bausteine, damit diese frei gelagert werden können.

Nachdem der IC-Baustein 30 nach bekannten Herstellungsverfahren mit den Leiterbahnen 31 verbunden worden ist, kaschiert man auf die den Baustein aufnehmende Aussparung 34 die Deckfolie 26.

Dabei wird der Baustein, wie Fig. 3 zeigt, mit Hilfe einer elastischen Klebstoffmasse 33 fixiert.

Für die manuelle Einzelfertigung von Ausweiskarten wird das Trägerelement 18 aus dem Folienverband ausgestanzt (strichlierte Linien in Fig. 3), so daß es als Einzelelement in das vorgesehene Fenster der Ausweiskarte eingesetzt werden kann. Die Ausweiskarte besteht in diesem Fertigungsstadium aus dem Karteninlett 12, auf dem die vorderseitige Deckfolie 16, die die Aussparung 24 für die Kontaktflächen des Trägerelements aufweist, auflaminiert ist.

Zur Positionierung kann die den Kontaktflächen 20 zugeordnete Aussparung 24 benutzt werden. Die Positionierung kann auch durch eine entsprechende, dem Fenster der Karte angepaßte Formgebung des Trägerelements durch eine Nut-Feder-Verrastung oder

ähnliches erfolgen. Nach dem Einsetzen des Trägerelements wird schließlich die rückseitige Deckfolie auflaminiert.

Für die Serienfertigung von IC-Ausweiskarten erfolgt die Positionierung automatisch, wobei die Trägerelemente, auf einem Transportband befestigt, gemeinsam mit den zu bestückenden Ausweiskarten taktisch synchron einer entsprechenden Einrichtung zugeführt werden.

In diesem Fall kann die an Trägerelement und Ausweiskarte für die manuelle Fertigung gegebenenfalls vorgesehene Positionierhilfe entfallen, d. h. das Trägerelement kann auch kreisförmig ausgebildet sein.

Unabhängig von der Art der Fertigung sind die beiden Deckfolien 14 und 16 aus hochelastischem Material im Vergleich zum Material des Trägerelements 18. Beim Biegen der Karte im Bereich des Fensters wird die Formänderungsarbeit zum größten Teil von den elastischen Folien aufgenommen. Das Trägerelement selbst bleibt von der Biegung weitgehend unbeeinflusst.

Wird das Trägerelement gegenüber den Materialien der Ausweiskarte sehr starr ausgeführt, muß die Formänderungsarbeit vollständig von den Deckfolien aufgenommen werden. Damit ist eine Beschädigung des Trägerelements gänzlich ausgeschlossen. Es muß aber im Gegensatz zum erstgenannten Fall, bei dem das Trägerelement einen geringen Teil der Formänderungsarbeit aufnimmt, mit einer früheren Ermüdung des Deckfolienmaterials gerechnet werden.

Abschließend sei erwähnt, daß die optische Gestaltung der Karte durch das eingebettete Trägerelement kaum beeinflusst wird. Die Karte kann also sowohl für die automatische als auch für die manuelle Prüfung eingesetzt werden.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

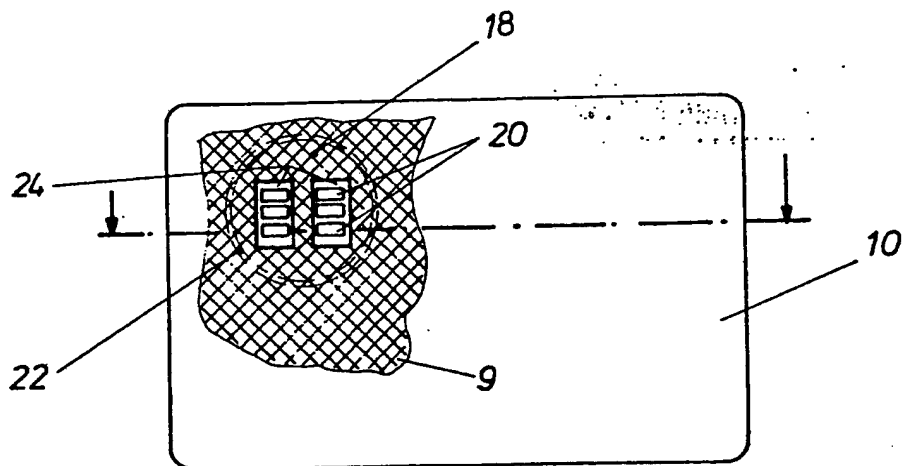


Fig. 1

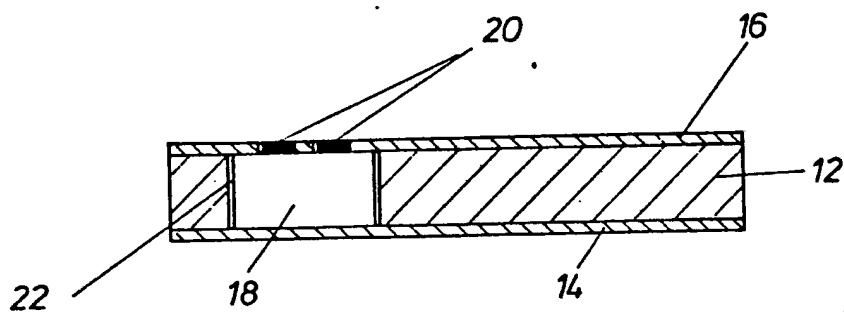


Fig. 2

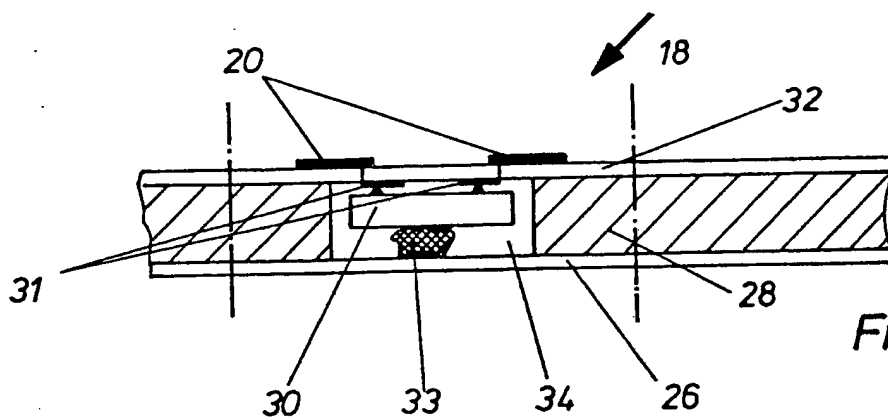


Fig. 3